

证券代码：688401

证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中金公司 2025 年度春季投资策略会、中信建投证券、中信证券、招商证券、天风证券、中邮证券、平安基金、鹏扬基金、民生加银基金、泰康基金、国泰基金、申万菱信基金、万家基金、博时基金、国泰君安资管、源乐晟资管
调研时间	2025 年 2 月 19 日-2 月 21 日
会议地点	中金公司 2025 年度春季投资策略会会场、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏先生 投资者关系：刘文鑫女士
投资者关系活动内容记录	<p>1、公司 2024 年四季度业绩超预期增长的原因？</p> <p>2024 年公司实现营业收入 8.76 亿元，同比增长 30.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿元，同比增长 29.21%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.74 亿元，同比增长 39.89%。分季度看，2024 年四季度实现营业收入 2.73 亿元，同比增长 43%，环比增长 32%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.71 亿元，同比增长 76%，环比增长 84%。上述财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准。</p> <p>公司业绩增长主要因素为：（1）公司产品掩膜版对应的下游需</p>

求旺盛；（2）技术升级、服务优化及产能扩张后更好地满足客户需求；（3）产品结构持续优化，高附加值产品占比进一步提升；（4）强化管理后的降本增效；（5）规模效应的综合体现。

2、公司 2025 年开年以来的经营情况？

2025 年开年以来下游需求旺盛，公司在 2024 年投产的产线预计会在一季度乃至全年会有不错的产能释放，截至目前公司增长延续四季的发展态势，伴随 2025 年新增产能的逐季度释放，内部产品结构的不断优化以及整体规模效应的进一步体现，我们对 2025 年的发展充满信心。

3、怎么看待公司的长期可持续增长？

公司对实现可持续性增长充满信心。纵观公司的发展之路，自 1997 年成立以来，公司已深耕掩膜版行业近三十年，不断拓展业务版图，深度参与了国内面板行业与半导体行业的产业变革升级，也贡献了自己的产业力量。公司连续多年保持营收与利润的双重增长，2019-2024 年公司营业收入年均复合增长率达 32%，2020-2024 年公司归属于母公司所有者的净利润年均复合增长率达到 56%，伴随着下游行业的发展升级，公司积极进行技术升级、产能拓展、客户对接，形成了自己的核心竞争力。

从量的角度来看，掩膜版的需求主要来自于下游产品的更新迭代、新技术的迭代应用、新场景的开拓应用，即与终端产品的多样性紧密相关，并不与下游的量价变动有直接联系，因此掩膜版并不受下游行业周期的影响，长期处于需求旺盛的状态，这与其他易受周期影响的半导体材料发展逻辑不同。目前公司产能有限，扩产以提升规模和市场份额迫在眉睫，公司已有多个扩产项目在规划推进中，预计 2025 年会有不错的新增产能释放。

从价的角度来看，掩膜版属于高度定制化的产品，下游新产品新技术都对掩膜版的精度提出了更高的要求，这使得掩膜版价格稳中有升；且掩膜版在下游客户成本结构中占比不高、但掩膜版的品质对于终端产品的质量具有决定性的影响，因此下游客户对掩膜版价格敏

感度较低。

从技术的角度来看，掩膜版的质量只有 0 和 1 的区别，同样精度的掩膜版，公司与海外掩膜版厂商的产品无任何差异，且本土掩膜版厂商的交期、服务会更有优势，下游客户基于对本土优势的认可以及供应链安全考虑，国产替代意愿强烈。

未来 5-10 年，公司都不会停止扩产的步伐，在国产替代的大背景下，下游需求旺盛、市场空间广阔、竞争格局良好，公司凭借综合竞争力和先发优势，扩产便能释放增量，转化为增长动力，当前，公司各项业务处于高速成长期，未来发展前景十分广阔。

除此之外，公司对并购重组持积极态度，目前考虑的方向包括但不限于产业链上下游拓展、海外/国内同业并购、合适的跨界布局等等，若市场上存在协同性较高的优质资产，公司会积极接洽，具体进展请关注公司公告。

4、公司的先进封装掩膜版，主要是应用在哪些环节？

公司已在先进封装方面前瞻布局、精耕细作发展多年，积累了深厚的技术底蕴，汇聚了丰富、优质的客户资源，封装分为传统封装和先进封装，下游众多传统封装客户正加速向先进封装转型。公司作为国内先进封装掩膜版龙头，是多个领先封测厂的头部供应商，技术的产品布局全面，产品可满足各种先进封装要求，例如晶圆级封装、2.5D/3D 封装、系统级封装、扇出型封装、CoWoS 先进封装等需求。

具体应用环节来看，掩膜版主要用于重布线层（RDL）、硅通孔（TSV）定义孔洞位置和尺寸、微凸点和焊球位置，先进封装掩膜版更关注图形精度和互连密度、多样化的图形需求、高良率等等。

5、公司的掩膜版在新能源汽车、机器人上面有哪些应用？

公司的掩膜版主要用于平板显示、IC 制造、IC 器件、IC 封装、MEMS（微型传感器）、LED 芯片、PCB 制造等等领域。新能源汽车在芯片、器件、屏幕上的使用量和种类相较传统燃油车的增长是十分可观的，这极大带动了对掩膜版的需求。机器人上面同样存在多种芯片、屏幕、PCB 以及多种传感器，这些在制造过程中都需要使用到掩膜版。

	<p>6、2025 年是否有新的市场拓展计划？</p> <p>立足现有主业，公司将持续进行产能扩充和技术升级，提升市场份额。重点市场包括高世代 TFT-LCD、高精度 AMOLED、Micro LED 对应的平板显示掩膜版领域以及半导体掩膜版领域。</p> <p>目前公司再融资项目、路芯 130-28nm 半导体掩膜版项目都在有条不紊的推进中。同时公司亦会以自有或自筹资金不断进行设备产线投资，升级产线，提升规模。</p> <p>7、公司如何在竞争中保持领先性，针对不断推进制程节点，做了哪些准备？</p> <p>在技术研发方面，公司积极与国内高校、知名客户、实验室等开展自研和共研，制定了具备前瞻性的技术研发规划。目前，公司已针对干法刻蚀、等离子束修补、半导体 PSM 工艺、电子束光刻、模拟光刻、反演光刻等等技术开展了一系列研究，并形成了一定的技术积累。公司投资的路芯 130-28nm 半导体掩膜版项目在有条不紊的推进，设备按计划有序采购，部分设备已于 2024 年年底开始陆续到场。该项目一期投资 14-16 亿元，覆盖 40nm 制程节点以上掩膜版；二期投资 4-6 亿元，覆盖 28nm 制程节点以上掩膜版。因此一期采购的大部分辅助设备可以覆盖到 28nm。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单	无